

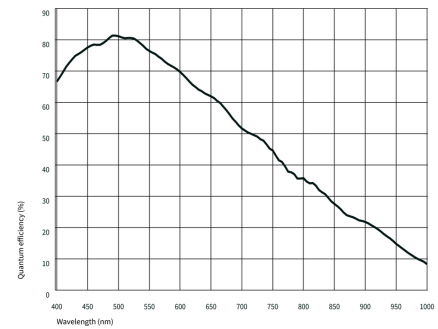
■ 양산 단계
이 모델은 양산 단계에 있으며 장기간 구매 및 사용이 가능합니다.



사양

센서

센서 타입	CMOS 모노
셔터	Rolling shutter
센서 특성	선형의
픽셀 등급	8 MP
해상도	8.41 Mpix
해상도 (h x v)	3864 x 2176 픽셀
중형비	4:3
ADC	12 bit
색 심도(카메라)	12 bit
광학 센서 등급	1/2.8"
광학 영역	5.603 mm x 3.155 mm
광학 센서 대각선	6.43 mm 1/2.8"
픽셀 크기	1.45 µm
CRA (주광선 각도)	0 °
제조사	Sony
센서 모델	IMX415-AAMR-C
게인(마스터/RGB)	27.5x/-
AOI 수평	동일한 프레임 레이트
AOI 수직	프레임 레이트 증가
AOI 이미지 너비/단차 너비	24 / 24
AOI 이미지 높이/단차폭	40 / 8
AOI 위치 그리드(수평/수직)	2 / 2
수평 비닝	프레임 레이트 증가
수직 비닝	프레임 레이트 증가
비닝 방법	수평: 평균 / 수직: 평균
비닝 요소	2x2
수평 decimation (서브샘플링)	-
수직 decimation (서브샘플링)	-
decimation (서브샘플링) 방법	-
decimation (서브샘플링) 요소	-



모델

프레임 레이트 프리런 모드	25 fps @ 10Bit
프레임 레이트 트리거(연속)	25 fps @ 10Bit
프레임 레이트 트리거(최대)	25 fps @ 10Bit
노출 시간(최소 - 최대)	0.019 ms - 1999 ms
전력 소비	0.5 W - 1 W
이미지 메모리	-

주변 조건들

아래 주어진 온도 값들은 카메라 하우징의 외부 장치 온도를 나타냅니다.

작동 중 허용되는 장치 온도	0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F
작동 중 허용되는 주변 온도	0 °C - °C / 32 °F - 32 °F
보관 중 허용되는 주변 온도	-20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F
습도(상대, 비응축)	20 % - 80 %

커넥터들

인터페이스 커넥터	USB 3.0 micro-B, 나사식
I/O 커넥터	8-핀 Wuerth 커넥터
전력 공급	USB 케이블

핀 할당 I/O 커넥터

1	전압 출력 3.3 V
2	접지 (GND)
3	오토커풀러 없이 플래시 출력 - Line 1
4	오토커풀러 없이 트리거 입력 - Line 0
5	범용 I/O (GPIO) 1 - Line 2
6	범용 I/O (GPIO) 2 - Line 3
7	접지 (GND)
8	USB 전원: 5 V, 최대 400 mA

Pin 1



디자인

렌즈 마운트	C-마운트
IP 코드	IP30
치수 H/W/L	29.0 mm x 29.0 mm x 17.0 mm
무게	61 g
하우징 자재	아연, 니켈 도금

Features

카메라 내 이미지 사전 처리 기능 목록입니다.

표의 모든 기능은 호스트 컴퓨터에서 이미지 전처리를 위한 IDS peak 소프트웨어를 통해 사용할 수 있습니다(센서 모델에 따라 다름).

이미지 획득

Freerun	✓
Software trigger	✓
Hardware trigger	✓
Trigger controlled exposure	-
Denoiser	-
Long exposure	-
Line scan	-
Global start	-

깜박임

Flashing	-
PWM flashing	-

기술적인 수정을 받아야 함 (2026-07-13)

2의 페이지 3

www.ids-imaging.kr

IDS Imaging Development Systems GmbH

Dimbacher Str. 10 · 74182 Obersulm · Germany · Phone +49 7134 96196-0 · E-mail info@ids-imaging.com

U3-38J0XCP-M-GL Rev.1.2 (1008737)

이미지 조정

Auto exposure	-
Auto gain	-
Auto whitebalance	-
Color correction	-
Gamma	-
LUT	-
Mirror/flip	X/Y

온보드 이미지 처리

Pixel formats	Mono10g40IDS Mono12g24IDS
Region of interest	✓
Decimation (FPGA)	-
Decimation (Sensor)	
Binning (FPGA)	-
Binning (Sensor)	2x2 Increases frame rate.

기타

Chunks	-
Sequencer	-
Events	-
Firmware update	✓
1st supported firmware version	3.20